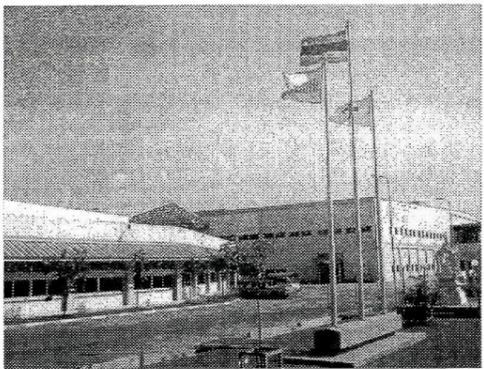


電機・電子部品

タイで冷蔵庫増産

日立アプライアンス 9割増



日立アプライアンス(東京都港区、山本晴樹社長、03・3502・2111)は2015年度をめぐり、タイ工場の冷蔵庫の生産能力を現状比9割増の150万台に増強する。数十億円を投じて機械の新設や更新を実施。タイを中核拠点として、大容量タイプなどの冷蔵庫を経済成長著しいアジアや中東向けに出荷していく。生産能力は現在の年80万台から12年度に120万台、15年度に150万台と段階的に増強する。

タイ東部にある「日立コンシューマ・プロダクツ・タイ(HCPT)」で冷蔵庫の生産能力を増強する。両開きドアを採用したタイプや、高効率のコンプレッサを搭載して省エネ性を高めたタイプなど、アジアの新興市場で今後、売れ筋になりそうな高付加価値製品冷蔵庫の生産能力を増強する「HCPT」

アジアや中東向け出荷

の生産を強化していく。タイ工場は11年に起き

た大洪水で、アユタヤ県ロツヤナ工業団地の冷蔵庫用コンプレッサの製造拠点「日立コンプレッサ・タイ(HCCT)」が49日間にわたって浸水し、生産を停止する影響を受けた。事業継続計画(BCP)として、コンプレッサ工場の周辺に最大2.7mの水位まで耐えられる防水壁を構築する計画を進める。自然災害が発生しても、冷蔵庫の構成部品であるコンプレッサを安定して供給できる体制も構築していく。

部品運搬車両 処理能力5倍

NECネットエスアイが東京都内に構える部品配送センター「PDOC(ピードックP写真)」

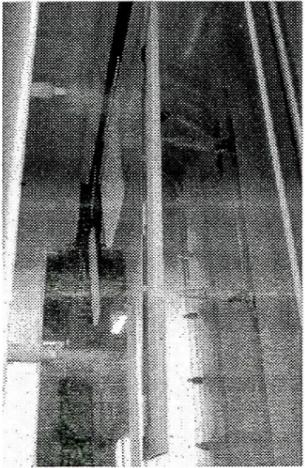
NECネットエスアイの改善活動が成果をあげている。一日当たりの部品運搬車両の処理能力を50台から5倍の250台に増加。しかも約1カ月の短期間で行った。取り組みでは開梱や検品作業を分割したほか、

11年9月期の売上高は27億8000万円。一連の設備投資で生産のリードタイムを縮め、「受注から3日間で製品を納入する体制」(野村社長)を目指す。

矢田工業所

塗装工程、2時間短縮

稲沢工場 自動化ライン新設



「名古屋」矢田工業所(名古屋市中区、野村憲一社長、052・721(名古屋市中区、野村憲一)は、エレベーター部品や分電盤ケースなどの金属部品を加工する稲沢工場(愛知県稲沢市)に自動化塗装ラインを新設(写真)した。投資額は1億5000万円。塗装工程にかかる時間を従来の半分の2時間に短縮し、繁忙期の作業負担を減らすほか、新規受注の獲得を狙う。前

工程の板金加工を手がける工場を稲沢工場付近に移転し生産の合理化も図った。

塗装ラインは同社で5本目。既に稼働しており、8月中にも1日あたりの塗装能力を200平方メートルにする。自動粉体塗装機を導入したほか、毎分1枚のペースで部品を自

ニコン、営業益850億円

今3月期予想を下方修正

ニコンは8日、2013年3月期連結業績予想で売上高、各利益項目とも下方修正したと発表した。レンズ交換式デジタルカメラやコンパクトデジタルカメラの競争激

11年9月期の売上高は27億8000万円。一連の設備投資で生産のリードタイムを縮め、「受注から3日間で製品を納入する体制」(野村社長)を目指す。

単位億円、増減率(前年3月期対比)は赤字・マイナス。配当の上段カッコ内は前年の実績。下段は当期見込み

売上高	2,594	(5.6)
営業利益	10,200	(11.0)
経常利益	233	(▼36.7)
当期利益	850	(6.1)
営業利益	234	(▼38.0)
経常利益	900	(0.7)
当期利益	157	(▼48.6)
営業利益	600	(1.2)

ニコン(4-6月期)

販売台数となり、売上高を押し上げた。だが、露光装置が振るわず、半導体用露光装置の販売台数は、前期比で半減となる9万台に落ち込んだ。液晶用はほぼ横ばいの22万台だった。

露光技術めぐり合従連衡

細化が進んでいる。集積度が増すと、その分、同じ大きさのウエハから多くのチップを製造できるため、半導体メーカーは製造コスト削減の切り札としている。

現在、最先端を行く半導体は回路線幅が20ナノメートル(ナノは10億分の1)まで微細化。次世代は同10ナノメートルの実現を目指している。

開発が進められている。EUVを採用した研究開発が進められているが、実用化から量産機の開発まで数億円かかると言われていた。

巨額開発費がネックとなり、ASMLはEUVの開発が遅れが生じていた。インテルとTSMCからの出資を受け入れて開発基盤を強化、ASMLは実用化時期を2年前倒しする考えだ。

戦略見直しも

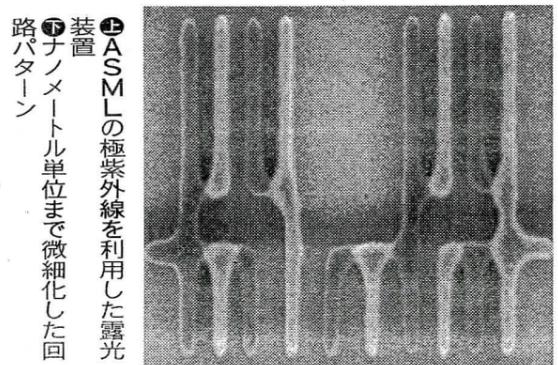
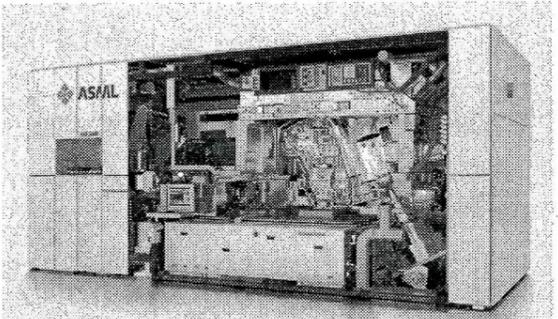
一方、ASMLと半導体大手の関係強化は、露光装置の生産性を高めたことから、あつという間にシエラを逆転された苦い経験がある。EUV開発で後れを取ると、厳しい局面に立たされることも想定できる。

半導体大手 + 半導体製造装置大手 「次世代」開発で連携

「経営への負担が大きいが、半導体のサプライチェーン全体で投資を分け合うことが必要だ」と(ピエー・ウェニングASML最高財務責任者)。

露光装置大手のASMLは自社単独による装置開発の限界を指摘する。このため、7月に次世代の露光装置開発を目的とした共同投資プログラムを掲げた。これにより、1社による装置開発を

「2年ごとに集積度が倍になる」いわゆるムーアの法則に沿って回路の微



ASMLの極紫外線を利用した露光装置

① ナノメートル単位まで微細化した回路パターン